

SEMI 3DIC Advanced Manufacturing Alliance (3DICAMA)

SEMI 3DIC 先進封裝製造聯盟 意向申請書

填表日期： / /

基本資料

公司名稱	中文：	英文：	
統一編號：	電話：		
公司地址：			
SEMI 會員：			
☐ 是 ☐ 否			
※備註：本聯盟成員資格之生效，以申請人完成 SEMI 會員入會為必要條件。申請人如於申請時尚未成為 SEMI 會員，仍得提出申請，惟須於審核通過後、成員資格生效前完成相關入會程序。			
申請類別：請勾選本次申請之成員身分			
☐ 核心成員 (Core Member) ☐ 一般成員 (General Member)			
※備註 1：經指定為核心成員之公司請直接勾選核心成員的選項，其包含一般成員所享權利 ※備註 2：未經指定為核心成員之公司，仍得於本次申請中一併勾選、提出核心成員申請。各類成員資格均須分別經審核通過後始生效，成員身分不因申請勾選而當然成立，亦不因未通過某一類成員審核而自動轉換或取得其他成員身分。申請人如僅勾選核心成員，將僅就核心成員資格進行審核；是否另行申請一般成員，請申請人依自身意願勾選；其資格審核每季辦理一次			
公司主要業務類別 (可複選)	☐ 晶圓製造 / Foundry	☐ EDA / 設計與模擬軟體供應商 / EDA & Design Software Provider	☐ 系統整合商 / System Integrator
	☐ 封裝與測試 / Assembly & Test (OSAT)	☐ 製造自動化與控制軟體 / Factory Automation & Equipment Control Software	☐ 服務與顧問公司 / Service or Consulting Company
	☐ IC 設計 / IC Design	☐ 設備製造 / Equipment Manufacturer	☐ 學研機構 / Academic or Research Institute
	☐ 材料供應 / Materials Supplier	☐ IP 供應商 / IP Provider	☐ 法人單位
			☐ 其他 (請說明) / Others (please specify): _____
公司目前主要從事或具備能力的先進封裝技術領域 (可複選)	☐ 2.5D / 3D IC Packaging (e.g., Interposer, TSV, SoIC, Foveros, X-Cube)	☐ SiP / AiP (System-in-Package, Antenna-in-Package)	☐ Chiplet / Heterogeneous Integration
	☐ Fan-Out Packaging (e.g., InFO, FOCoS, FOWLP, FOPLP)	☐ Die Stacking / Hybrid Bonding (e.g., DBI, direct bonding)	☐ Test and Probing for Advanced Packaging
	☐ CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)	☐ Advanced Substrate / Interconnect Technologies (e.g., RDL, Embedded Bridge, Glass Substrate)	☐ Metrology and Inspection for Advanced Packaging
			☐ Materials & Process Development
高階參與代表資訊	姓名	中文：	英文：
	職稱	中文：	英文：
	電話/分機：		手機：
	Email：		
高階秘書資訊	姓名	中文：	英文：
	電話/分機：		手機：
	Email：		

公司簡介

中文（建議 200–400 字）：

英文（建議 200–400 字）：

進階資料

公司資本額：		年營業額：	總員工數：
台灣的技術人員	總數：	分布數量 ※備註：請以人數呈現 製程研發／工程設計：____ 製造與測試支援：____ 材料研發／化學分析：____ 現場應用與技術服務（FAE/FSE）：____ 自動化與軟體控制：____ 品質與可靠度管理：____	
	教育程度分布 ※備註：請以技術人員總數之%呈現 學士：____ / 碩士：____ / 博士：____		
貴司前三大強勢產品及獨特技術			
貴司於先進封裝領域的主要產品及技術領域之說明			
貴司目前的主要客戶 ※備註：本欄位所提供之資訊，僅供聯盟入會審核與工作小組適配評估之參考使用，將依《SEMI 3DIC 先進封裝製造聯盟章程》及 SEMI 相關保密與資訊管理規範處理，非經授權不對外揭露。			
貴司希望可以透過聯盟得到怎樣的資訊及協助、及期待的討論項目			
貴司認為可以在聯盟中帶來的貢獻			

工作小組申請與代表人資訊（僅提供申請核心成員之公司填寫）

本節資訊適用於申請或經指定為「核心成員」之公司填寫。一般成員無須填寫本節，聯盟將依申請類別及審核結果，確認是否進行工作小組安排。

目前聯盟預計成立三個工作小組（Special Interest Group，SIG），分別為標準、封裝製程技術、量測檢測技術工作小組，其工作目標如下。貴司可以選擇至多參加 2 個工作小組（必須包含原指定小組，若原指定小組為 2 個，則不可再選第 3 個）

標準工作小組

- 帶動國內 3DIC 設備供應商技術升級，強化設備之自動化控制、系統整合、資料處理、邊緣運算、即時監控、資訊安全等 AI 智慧化功能。
- 建立一個「自動化／防禦技術交流平台」，供成員共享技術與經驗資源，在提升產品性能與品質為前提下，進一步改善作業效率與資訊安全，強化 3DIC 產業的競爭力，並協助成員導入 SEMI 新標準。

封裝製程技術工作小組

- 封裝材料：開發與目前晶圓廠及 OSAT 製程中使用的 POR 材料相容的封裝材料，並涵蓋次世代技術需求。重點領域包括 PI/PR、UF/封裝膠、膠帶、蝕刻藥劑
- 製程設備：重點提升設備能力包括自動化、即時監控/感測防護、軟體整合、操作穩定性、變更管控標準作業程序(SOP)以及提高產能效率。

量測檢測技術工作小組

聚焦於提升先進封裝各製程的內部缺陷檢測準則與追溯系統，具體目標包括：

- 建立內部缺陷檢測的標準化規範，涵蓋 X-ray、聲波掃描（SAT）等檢測技術，以確保檢測結果的一致性與可比性
- 提供量測所需的標準樣本（Golden Sample），作為製程驗證與設備比對的標準依據
- 開發晶圓製程與先進封裝製程間的對應系統，透過晶圓對位圖（Wafer Mapping）與可追溯機制，實現全流程製程與品質追蹤
- 推動自動測試系統（ATS）、AI 深度學習演算法及 MES 整合，以提升智慧化與自動化檢測能力。

選擇一：預計加入 ☐標準工作小組 ☐封裝製程技術工作小組 ☐量測檢測技術工作小組

※備註：以下資訊旨在協助工作小組領導人了解申請參與工作小組之代表人是否可代表公司進行技術意見交流，其技術背景與討論適配性，並非個人資格審查。聯盟將依據所提供之資訊，綜合評估工作小組參與安排。

工作小組 代表資訊	姓名	中文：	英文：
	職稱	中文：	英文：
	所屬部門	中文：	英文：
	電話/分機：	手機：	
	Email：		
	學歷	最高學歷 ☐ 學士 ☐ 碩士 ☐ 博士	
		主修領域：	畢業學校：
請簡述代表人於先進封裝、3DIC 或相關領域之實務或研發經驗，例如：曾參與之製程節點、材料／設備類型、量測技術、標準制定或跨公司專案經驗等（建議 200-400 字）			

選擇二：預計加入 ☐標準工作小組 ☐封裝製程技術工作小組 ☐量測檢測技術工作小組

※備註：以下資訊旨在協助工作小組領導人了解申請參與工作小組之代表人是否可代表公司進行技術意見交流，其技術背景與討論適配性，並非個人資格審查。聯盟將依據所提供之資訊，綜合評估工作小組參與安排。

工作小組 代表資訊	姓名	中文：	英文：
	職稱	中文：	英文：
	所屬部門	中文：	英文：
	電話/分機：	手機：	
	Email：		
	學歷	最高學歷 ☐ 學士 ☐ 碩士 ☐ 博士	
		主修領域：	畢業學校：
請簡述代表人於先進封裝、3DIC 或相關領域之實務或研發經驗，例如：曾參與之製程節點、材料／設備類型、量測技術、標準制定或跨公司專案經驗等（建議 200-400 字）			

- ☐ 我已閱讀 [SEMI 3DIC 先進封裝製造聯盟草案](#) 並理解其內容，並同意依相關原則申請加入聯盟。
(此草案為聯盟初期說明文件，實際權利義務將以未來正式章程為準)
-

填寫人資料

姓名：

職稱：

電話：

手機：

Email：